

DWG. NO.
SD-53268-**-20

E

D

C

B

A

mm DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8

7

6

5

4

3

2

1

F

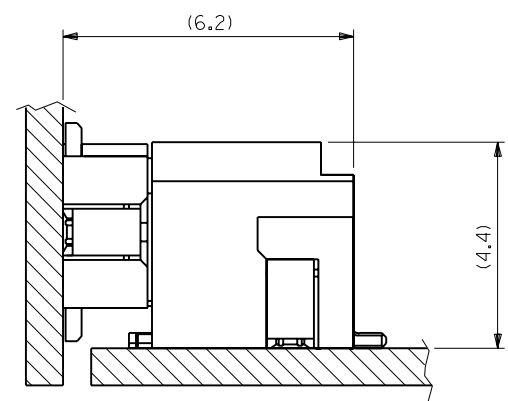
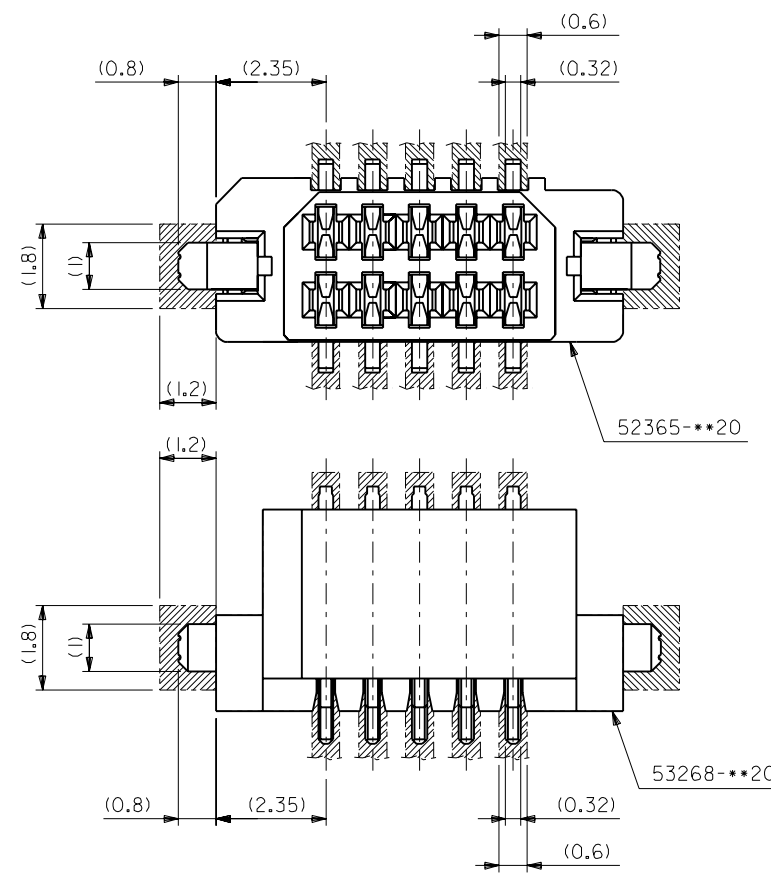
E

D

C

B

A



基板取付推奨レイアウト
RECOMMENDED P.C.BOARD LAYOUT

角度	ANGLE
30°以上	OVER
10°以上	OVER
10°以下	UNDER
未過	UNDER
一般公差	GENERAL TOLERANCES

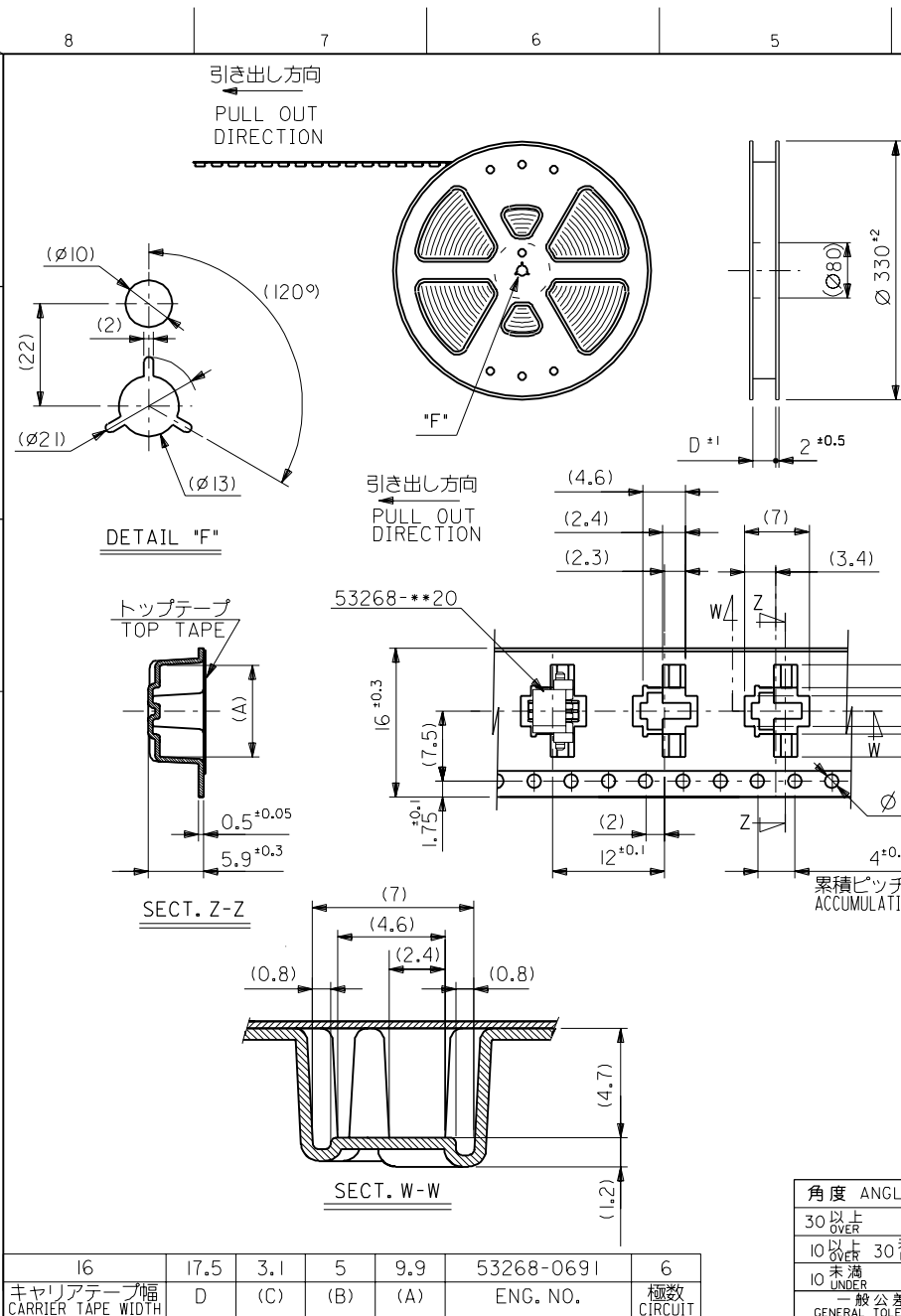
0.2	A	再作 ☒ REDRAWN (J206
	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD

DR.	CHK.	DATE
DR.	CHK.	DATE

材料	MATERIAL
SHEET 1 OF 2 参照	REFER TO SHEET 1 OF 2
仕上げ	FINISH
適用電線範囲	WIRE RANGE
被覆外径	INS. RANGE
DRAWN BY	CHK'D BY
S. AIHARA	M. KUSUMOTO
APP'D BY	尺
M. KUSUMOTO	度
尺	度
度	度

材料	MATERIAL
SHEET 1 OF 2 参照	REFER TO SHEET 1 OF 2
仕上げ	FINISH
適用電線範囲	WIRE RANGE
被覆外径	INS. RANGE
DRAWN BY	CHK'D BY
S. AIHARA	M. KUSUMOTO
APP'D BY	尺
M. KUSUMOTO	度
尺	度
度	度

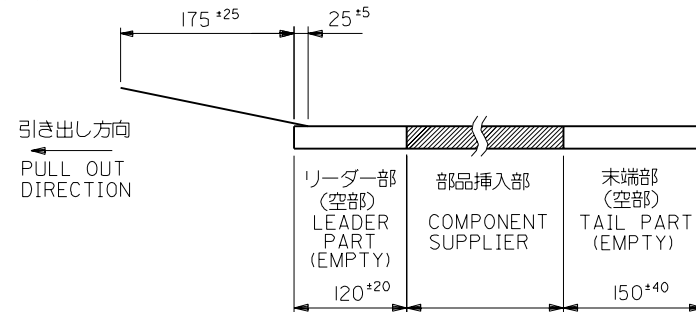
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。
EN-01C(032)MXJ-32



注記 NOTES

1. 梱包数量: 1000 個/リール NUMBER OF CONNECTORS: 1000PCS/REEL
2. リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

トップテープ TOP TAPE
リーダー部 LEADER PART
未接着部 NON-BONDED PART



3. トップテープの剥離強度: (剥離方向は下図参照)

60gf MAX. 尚、本規格値は、出荷時に適用。
(但し、輸送時に剥離が発生しない事。)

PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE
60gf MAX. (PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED,
DURING TRANSPORTATION



4. 材料

キャリアテープ: ポリプロピレン (PP) CARRIER TAPE: POLYPROPYLENE
トップテープ: PET, PE, PEF TOP TAPE: PET, PE, PEF
リール: ポリスチレン (PS) REEL: POLYSTYREN (PS)
<リサイクル材を含む> <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	モレックス MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
D 変更 REVISED (UC2001-042)	仕上げ FINISH	EDP. NO. ---
C 変更 REVISED (J30601)	適用電線範囲 WIRE RANGE	ENG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV D
B 変更 REVISED (J20879)	被覆外径 INS. RANGE	TITLE 名称 I.O BtB Conn Wafer Assy RA SMT Embstp Pkg
A 変更 REVISED (J20684)	DRAWN BY '90/5/8 T.HARUYAMA CHK'D BY '00/12/6 T.IITO	
O 新規作成 PROPOSED (J00464)	APP'D BY '00/12/6 M.FUKUSHIMA 尺度 SCALE ---	
記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	
DR. CHK. DATE		

角度 ANGLE	一般公差 GENERAL TOLERANCES
30 以上 OVER	± 0.5
10 以上 30 未満 OVER 10 UNDER 30	± 0.25
10 未満 UNDER	± 0.2

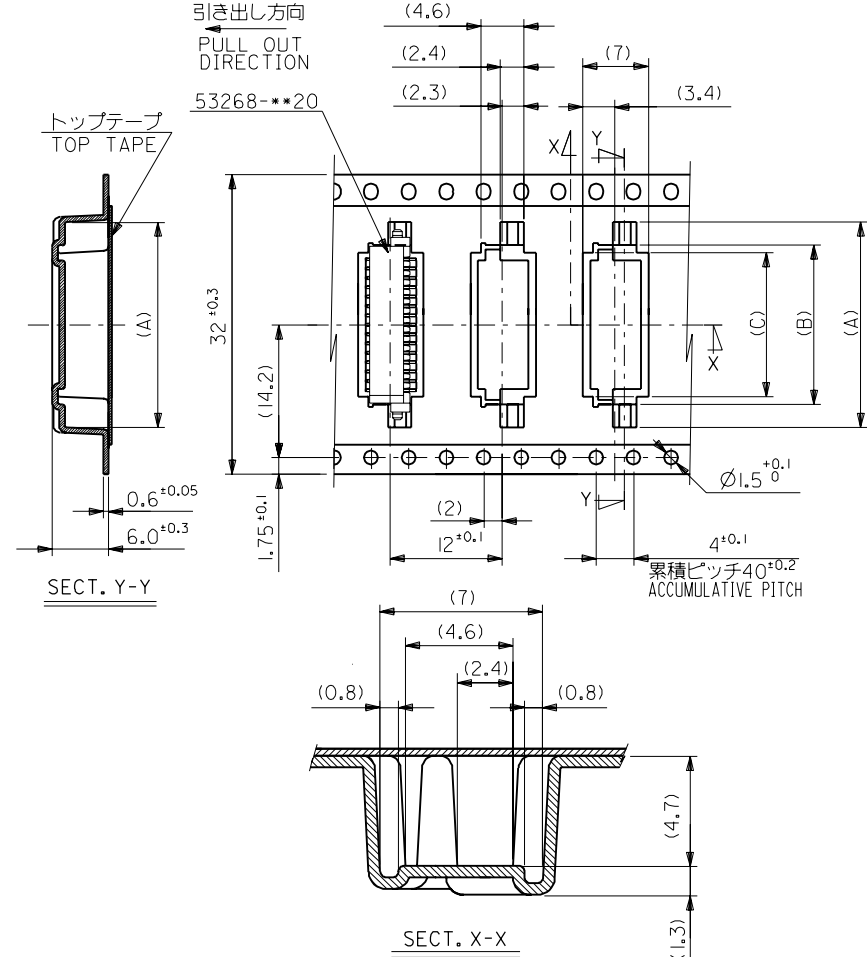
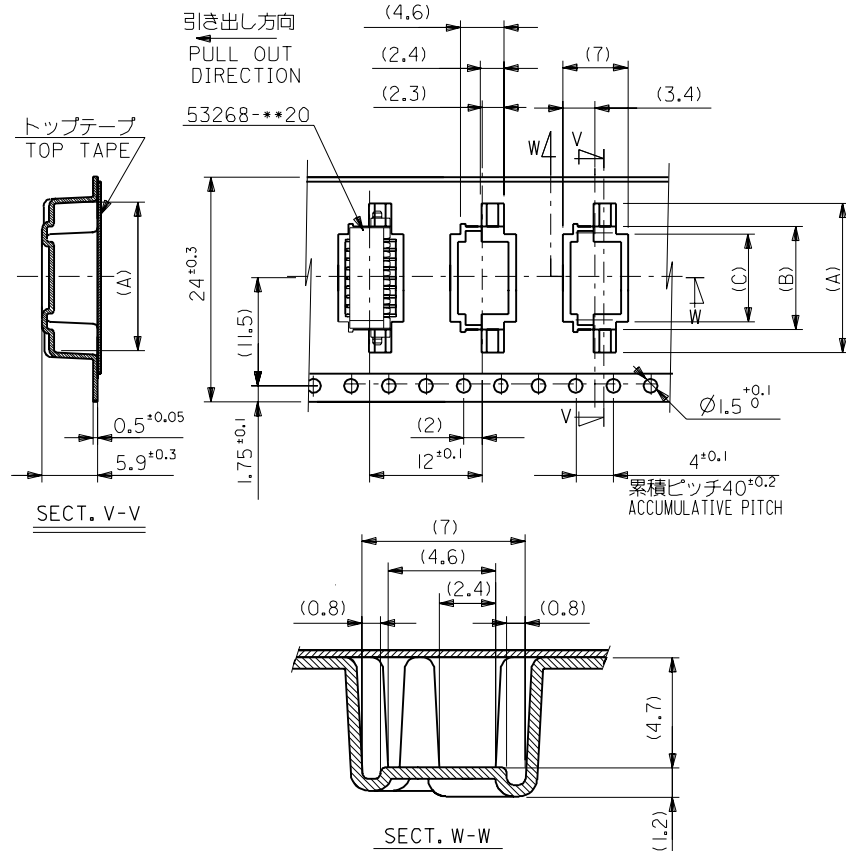
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス (株) の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

MXJ-8

ENG. NO.
SD-53268-***91

EDP NO.

※MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



32	33.5	15.15	17	21.9	53268-3091	30
		14.15	16	20.9	53268-2891	28
		13.15	15	19.9	53268-2691	26
		12.15	14	18.9	53268-2491	24
24	25.5	11.1	13	17.9	53268-2291	22
		10.1	12	16.9	53268-2091	20
		9.1	11	15.9	53268-1891	18
		8.1	10	14.9	53268-1691	16
		7.1	9	13.9	53268-1491	14
		6.1	8	12.9	53268-1291	12
		5.1	7	11.9	53268-1091	10
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	(C)	(B)	(A)	ENG. NO.	極数 CIRCUIT

角度	ANGLE
30°以上	OVER
10°以上 30°未満	OVER 30 UNDER
10°未満	UNDER
一般公差	GENERAL TOLERANCES

材料 MATERIAL		SHEET 1 OF 2 参照 REFER TO SHEET 1 OF 2		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
D	変更 REVISED	(J2001-0421)	100/12/6	EDP NO. —	
C	変更 REVISED	(J30601)	93/6/22	ENG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV	
B	変更 REVISED	(J20879)	92/9/20	SD-53268-***91 D	
A	変更 REVISED	(J20684)	92/8/3	TITLE 名称	
O	新規/改訂 PROPOSED	(J00464)	90/5/8	I.O B+B Conn Wafer Assy	
記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD	DR. 日付 CHK. DATE	RA SMT Embstp Pkg	
REVISION RECORD		DRAWN BY 90/5/8 T.HARUYAMA		CHK'D BY 100/12/6 T.IITO	
REVISION RECORD		APP'D BY 100/12/6 M.FUKUSHIMA		尺度 SCALE	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

MXJ-8